114 學年度入學-日四技【系畢業門檻：領域】：自我檢核表
詳如以下 2 頁。
114 學年度入學學生，於 114.8.1 入學，現為大二，但請依時程類推年級。

1. 文件為 115.9.19 版，日後會繼續改版
2. 學生修讀校外實習(一)、或校外實習(二)者，則畢業「檢核二」，認定為免檢核(視為通過)；但不核發領域證書。
   ↑↑↑這裡的校外實習是指"半年型"的，不是暑假的。
3. 本文件提到有三個畢業資格檢核，與選修、領域、領域必選課程有關。
4. 自我檢核表，師生、系辦仍可繼續「除錯、減少 bugs」；若有錯誤，將記錄日期，重新修改內容。

114 學年度入學-電子工程系日四技【系畢業門檻：領域】──自我檢核表

115.9.19 版，日後會繼續改版

班級：＿＿＿＿＿＿＿＿姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

備註：學分計畫表，必選課程以「※」表示，本單改為「★」，意思一樣。

檢核一：學生來自哪一班？舉例：丙班的學生，就看丙班那一欄，即可。

甲班學生要修讀：積體電路與系統應用領域「★」其中的三門	乙班學生要修讀：多媒體遊戲暨智慧運算領域「★」其中的三門	丙班學生要修讀：智慧機器人領域「★」其中的三門
□★VLSI 概論 ＝(超大型積體電路設計導論)	□★工程軟體應用 ＝(工程軟體應用實作)	□★工業機器人原理與應用
□★嵌入式軟體設計實務 ＝(嵌入式軟體設計)	□★嵌入式微處理器系統 ＝(嵌入式微處理器系統與實習)	□★自動化系統整合與應用
□★太陽能光伏電子系統	□★數位影像處理 ＝(數位影像處理實作)	□★智慧感測與監控實務
□★半導體物理導論	□★嵌入式系統開發實習	□★電腦機構繪圖
□★光電轉換導論	□★電腦圖學	□★機器人程式設計(1)-初階工程師
□★嵌入式系統應用 ＝(★嵌入式系統概論與實習)	□★網路概論	□★機器人程式設計(2)-中階工程師
□★電力電子積體電路設計	□★Python 程式語言 ＝(Python 程式設計)	□★機器視覺
□★類比積體電路設計		
□★FPGA 系統設計 ＝(FPGA 系統設計實務)		
□★低功率積體電路設計		

註：新增★三門，於 104.11.5 綠能晶片與系統應用領域會議決議通過。

檢核三：

畢業至少應修滿 128 學分【必修 75 學分，選修至少 53 學分(須含本系專業選修至少 36 學分)】。

一、舉例：【專業選修】佔≧36 學分：指領域選修、電子系日夜所開四技、二技選修。

二、舉例：【非專業選修】得佔≦17 學分：指跨系選修、體育選修、軍訓選修……。

三、 問：我的博雅通識領域課程選修，多修了，是否可轉為【非專業選修】？　　答：可算是【非專業選修】。

■114 學年度入學-日四技，學分計畫表，下載：https://bit.ly/2TJci5F

■本表改版，會公布在系網，短址為：https://bit.ly/3xntnkm

檢核二：關鍵字：「領域」不會綁學生來自哪一班、或哪一個招生組別；代表可以自由跨組選修。
甲乙丙學生應修讀下述三個「領域」其中一個，為其畢業之基本條件。
舉例：甲班可自由選擇「積體……領域」、或「多媒體……領域」、或「智慧……領域」，為學生本人的(選修聚焦)領域。
註：學生修讀校外實習(一)、或校外實習(二)者，則畢業「檢核二」，認定為免檢核(視為通過)；但不核發領域證書。
↑↑↑ 這裡的校外實習是指"半年型"的，不是暑假的。

積體電路與系統應用領域： 學生至少要修以下 7 門課；且含「★」的課，要佔 2 門或以上。	多媒體遊戲暨智慧運算領域： 學生至少要修以下 7 門課；且含「★」的課，要佔 2 門或以上。	智慧機器人領域： 學生至少要修以下 7 門課；且含「★」的課，要佔 2 門或以上。
□★VLSI 概論 ＝(超大型積體電路設計導論)	□★工程軟體應用 ＝(工程軟體應用實作)	□★工業機器人原理與應用
□★嵌入式軟體設計實務 ＝(嵌入式軟體設計)	□★嵌入式微處理器系統 ＝(嵌入式微處理器系統與實習)	□★自動化系統整合與應用
□★太陽能光伏電子系統	□★數位影像處理 ＝(數位影像處理實作)	□★智慧感測與監控實務
□★半導體物理導論	□★嵌入式系統開發實習	□★電腦機構繪圖
□★光電轉換導論	□★電腦圖學	□★機器人程式設計(1)-初階工程師
□★嵌入式系統應用 ＝(★嵌入式系統概論與實習)	□★網路概論	□★機器人程式設計(2)-中階工程師
□★電力電子積體電路設計	□★Python 程式語言 ＝(Python 程式設計)	□★機器視覺
□★類比積體電路設計	□計算機組織與結構 ＝(計算機結構)	□深度學習 ＝(深度學習應用)
□★FPGA 系統設計 ＝(FPGA 系統設計實務)	□作業系統概論 ＝(作業系統)	□單晶片微電腦應用 ＝(單晶片微電腦應用實務)
□★低功率積體電路設計	□深度學習 ＝(深度學習應用)	□嵌入式微處理器系統 ＝(嵌入式微處理器系統與實習)
□3D 列印技術實務 ＝(3D 列印導論與實務) ＝(3D 列印原理與實務)	□3D 動畫技術	□工程圖學
□全客戶 IC 佈局	□物件導向程式設計	□工業無線通訊技術
□太陽能系統與應用	□虛擬實境	□可攜式電源設計
□半導體元件導論	□雲端科技應用	□自動化光學檢測概論
□射頻積體電路導論	□遊戲企劃	□自動化圖控介面
□高速 PCB 設計	□遊戲製作	□控制系統
□微控制器系統實務	□演算法	□電力電子學
□電磁相容之標準與測試	□遊戲物理導論	□機構設計
□電磁相容原理	□物聯網概論	□機器學習
□積體電路製程	□人工智慧	□自動化設備設計與組裝
□電路板製造與產業概論	□機率與統計	□光機電整合
□人工智慧晶片導論	□影像處理概論	
□IC 測試技術	□視窗程式設計	
□IC 封裝技術	□數位信號處理	
□半導體元件模擬	□資料庫系統應用	
□運算放大器設計實務	□3D 物件建模技術	
□半導體設備概論 ＝(半導體製程設備)	□單晶片微電腦應用 ＝(單晶片微電腦應用實務)	
□電磁相容實務	□資料結構	
□記憶體元件	□數位成音(一)	
□材料科學概論	□數位成音(二)	
□生醫感測器概論	□機器人程式設計 ＝(工業機器人程式設計)	
□數位 IC 導論	□機器學習	
□電能轉換電路設計	□虛實整合製作	
□印刷電路板製程技術與檢測		
□電子封裝技術與材料		
□半導體薄膜工程與元件		
□微波工程導論		
□光電元件導論		
□半導體製程導論		
□機電概論		
□先進封裝材料與製程		
□複合材料導論		
□先進半導體製程整合		
□奈米科技導論		